

企業、業界、M&A、開示資料、ニュース、レポート、IR・統計、トレンド、特許、FLASH Opinionを検索

チケット残数
5.00 枚

業界を探す

業界概要

プレイヤー一覧

プレイヤー散布図

スタートアップ

ニュース

M&A

統計

IRデータ

レポート

業界指数

フォトマスク業界 世界

ダウンロード

世界

TWN

調査担当：Uzabase/ハイテク・資本財セクターチーム 最終更新日：2025年04月02日（最終訂正日：2025年04月02日）グラフは自動更新されます

業界基本情報

業界定義	フォトマスク（半導体素子製造過程で用いる原板）を製造する企業群
関連業界	電子材料
関連トレンド	-
関連業界団体等	、 半導体産業研究所、 日本電子デバイス産業協会 (NEDIA)、 電子情報技術産業協会 (JEITA)

最新M&A案件 全ての業界M&A案件情報を見る

TOPPAN Holdings to repurchase shares

自己株式取得 - 取得価格 30,000 百万円 公表 - 2025/05/14

Dai Nippon Printing to buyback shares

自己株式取得 - 取得価格 50,000 百万円 公表 - 2025/05/13

Taiwan Mask injects capital in Youfu Investment

買収 - 取得価格 3,325 百万円 公表 - 2025/05/05

Asahi Shimbun and Dai Nippon Printin announces offer price to sell shares in TV Asahi Holdings

少数持分取得 - 取得価格 20,329 百万円 公表 - 2025/04/14

BlackRock Fund Advisors acquires stake in Dai Nippon Printing

少数持分取得 - 取得価格 7,254 百万円 公表 - 2025/03/31

最新ニュース 全ての業界ニュースを見る

【決算公告】株式会社DNPファインオプトロニクス（令和7年3月31日現在）

フォトリソ - 5～7月も減収想定 - レガシーIC用が低迷

ジューダット | フォトマスク静電破壊検証のリリース

【決算公告】株式会社DNP生活空間（令和7年3月31日現在）

【決算公告】株式会社DNPテクノリサーチ（令和7年3月31日現在）

メニューを閉じる

レポートサマリー

<p>業界概要</p> <ul style="list-style-type: none">・ 市場規模50億ドルの業界、主な成長市場は中国・ フォトマスクは半導体・FPD製造時の回路パターン転写テンプレート・ 垂直統合型のメーカーが市場で優位を占める・ 半導体業界は課題を抱えながらも、先端技術を用いた代替リソグラフィ工程へシフト・ 販売量は仕様決定のタイミングに左右される、価格は歩留まり向上と激しい競争から下落傾向・ 固定費の高さが収益性・歩留まりに影響	<p>市場環境</p> <ul style="list-style-type: none">・ フォトマスク市場は今後も成長する見通し・ マイクロエレクトロニクス業界の先端技術ノードへの移行が加速、ハイエンド・フォトマスクへの需要が高まる・ 家電製品の需要増に伴い、既存サイズのフォトマスク需要が好調・ 最大のフォトマスク市場は依然としてアジア太平洋、中国は大きな成長可能性を示す <p>競争環境</p> <ul style="list-style-type: none">・ 競争激化と資本集約度の上昇を背景に専業メーカー間での統合が進む・ HOYA：マスクブランクス製造の世界的大手・ Photronics：フォトマスク市場の主要専業企業・ エスケーエレクトロニクス：FPD用フォトマスクの大手メーカー・ 主要企業の売上高はEUVとエンドユーザーからの需要減を背景に減少している
--	--

業界概要

<p>市場規模50億ドルの業界、主な成長市場は中国</p> <p>フォトマスク製造は、半導体、各種フラットパネルディスプレイ（以下FPD）、その他の電気・光学部品などの製造における中間工程として重要な役割を担う。フォトマスクは「マスター・テンプレート」として、リソグラフィ工程で半導体ウエハやガラス板に回路パターンを光学的に転写する。</p> <p>半導体業界は、デバイスの高強度化・小型化に注力しており、フォトマスクはチップの超小型化における最先端分野といえる。また、有機ELディスプレイ（OLED）やタッチスクリーン技術の普及拡大に加え、デバイスのディスプレイデザインの高度化・大型化するなかで、より精細で複雑なフォトマスクの需要が高まっている。半導体・FPDメーカーは、これまで先端デバイスの製造期間を短縮するため主に垂</p>	<p>市場調査会社IMARCによると、世界のフォトマスク市場は2024年時点で約50億ドル規模に達した。通信業界や自動車業界、家電業界など幅広い業界において先進半導体需要が高まっていることがこの背景にある。なかでも中国のフォトマスク市場は、半導体・FPD製造に対する手厚い政策支援と生産能力拡大による自給体制の強化に下支えされ、堅調な成長が見込まれる。</p>
--	--

直統合型のプロセスを採用してきた。しかし近年では、内製でのフォトマスク製造能力を強化しており、専門フォトマスクメーカーの地位を脅かしている。

フォトマスクは半導体・FPD製造時の回路パターン転写テンプレート

フォトマスクは、半導体・FPD設計者や、その他の高性能電子機器メーカーなどの顧客が提供する回路設計を基に製造される。精度、効率、製造能力の高さが要求されるため、温度、湿度、清浄度が管理されたクリーンルームで行われる。

フォトマスクの製造工程

工程	概要
ブランクスの調達	フォトマスクブランク（溶融シリカ（QZ）またはガラス（SL）基板から作られる）を主に日本と韓国を拠点とする外部サプライヤーから調達
描画	フォトマスクブランクの表面にレジスト（感光性樹脂）を均一に塗布し、電子／レーザービームを用いて回路パターンを描画
現像	現像により、ビームによって露光された部分が除去される（ポジレジスト）、または露光部分が残る（ネガレジスト）
エッチング	遮光膜が露出した部分を化学反応（ドライエッチング）を用いて加工
レジスト除去・テスト	レジストの除去、洗浄を行いフォトマスクが完成。検査工程などを経て出荷

出所：Uzabase作成

垂直統合型のメーカーが市場で優位を占める

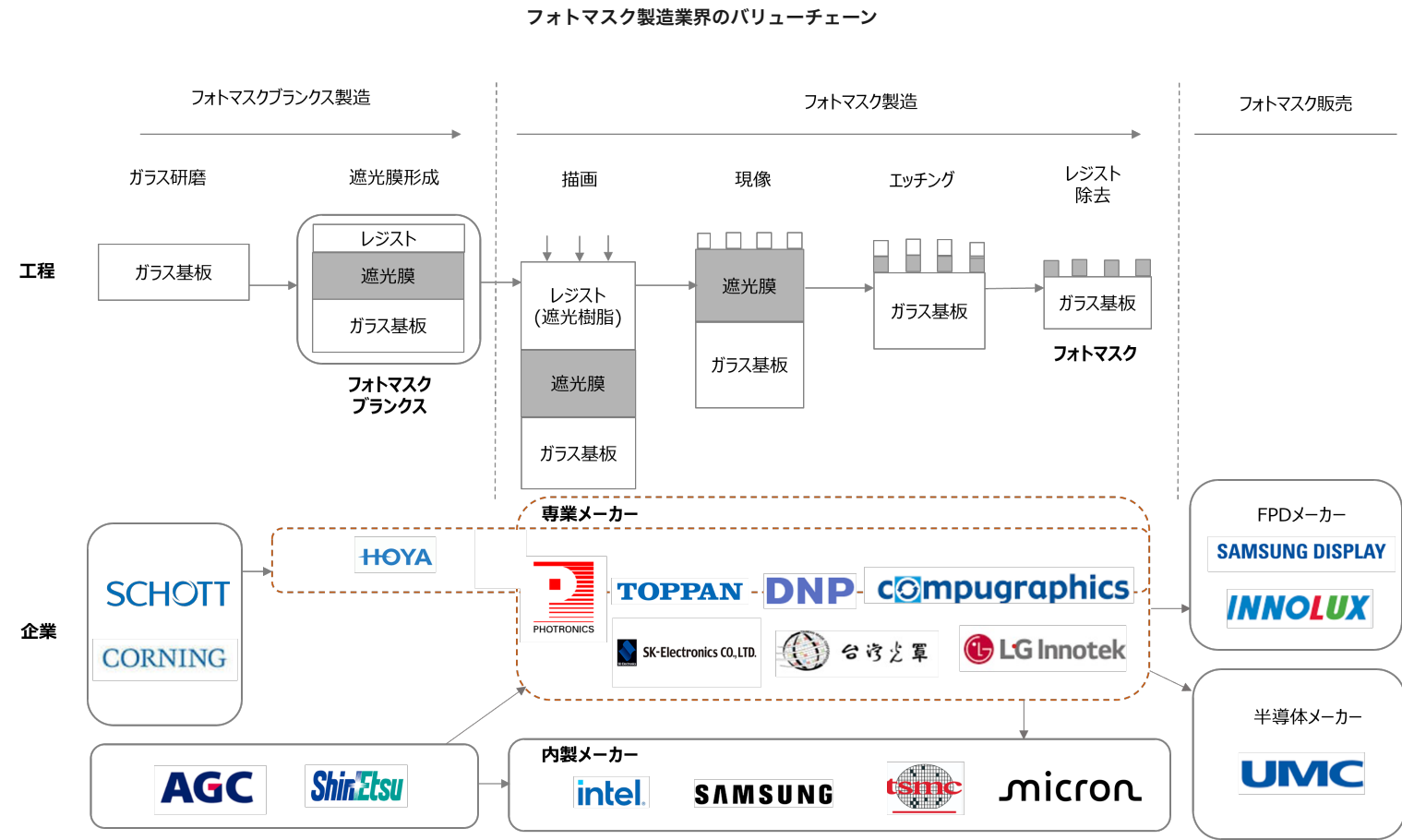
- フォトマスクメーカーには以下の2種類がある。
- 1) 専門メーカー：半導体メーカーやパネルメーカーにフォトマスク製品を販売する独立系メーカー
 - 2) 内製メーカー（垂直統合型の企業）：社内利用の目的でフォトマスクを内製する半導体・FPDメーカー
- 国際半導体製造装置材料協会（SEMI）によると、現在は内製メーカーが市場で優位を占め、2020年ではシェア約65%に達し、2008年時の

また、特定のマイルストーン達成を目指し、専門メーカーよりも速いペースで投資を行う内製メーカーもある。[Samsung Electronics](#)（KOR）などの先端デバイスメーカーは、垂直統合による短納期化を重視しており、またフォトマスク製造に投資できる規模をもつため、それに対応できる内製マスクショップの整備が事業要件となりつつある。

一方、フォトマスク製造には多額の設備投資が必要であり、十分な

約41%からシェアを拡大している（Sematech調べ）。この背景には、従来専業メーカーにフォトマスク製造を頼っていた半導体メーカーの一部が、ファブレス化により、フォトマスクを内製する [Taiwan Semiconductor Manufacturing](#)（台湾積體電路製造、TWN、略称TSMC）などのファウンドリを頼るようになったことがある。

スケールメリットを確保できない半導体・FPDメーカーの間では内製フォトマスク事業の売却・廃止が加速している。



出所：Uzabase作成

半導体業界は課題を抱えながらも、先端技術を用いた代替リソグラフィ工程へシフト

半導体・FPD製造で主に用いられる技術は、光リソグラフィ（UVリソグラフィ）と電子ビームリソグラフィである。これらの技術により、複雑な半導体やFPD製品向けにより微細な線の描画やより高精度な重ね合わせが可能となる。UVリソグラフィではレーザー光で回路パターンを転写する。電子ビームリソグラフィでは集束電子ビームで回路パターンを形成する。これらのリソグラフィ工程を用いて、専門メーカーが製造するフォトマスクの多くが、IC用では32ナノメートル（nm）以上のサイズ、FPD用では第8世代以下（既存サイズのフォトマスクとも呼ばれる）である。

極端紫外線（EUV）リソグラフィは、13.5nmという非常に短い波長の光を用いて、ICの高性能化・小型化を可能にする技術である（UVリソグラフィでは193nm）。同技術は、[Samsung Electronics](#)が2018年に7LPPノードのチップを生産した際に初めて採用している。[Intel](#)

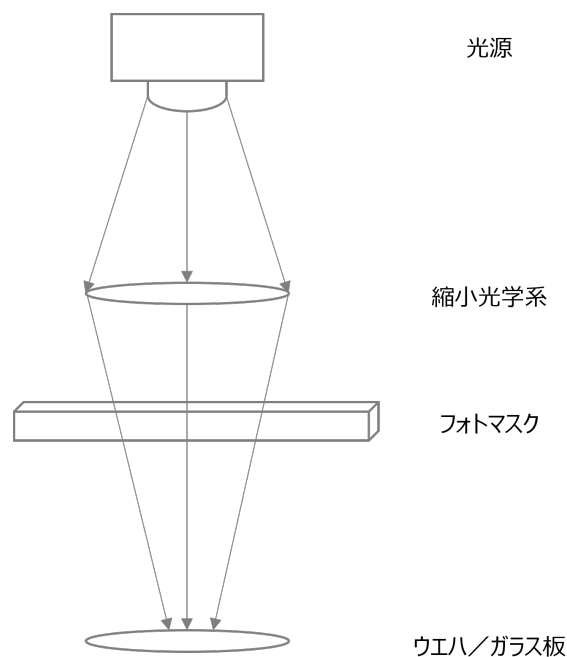
（USA）は2023年、アイルランド工場でEUVリソグラフィ技術を採用した「Intel 4」での半導体の量産を開始した。欧州での量産開始は今回が初となる。

EUVにはコストがかさむことや、マスクブランクス・検査装置・レジスト・露光装置といった主要インフラの整備が十分に進んでいないなど、大量生産にあたって複数の課題があるが、特に半導体業界での普及拡大が期待されている。これは、EUVリソグラフィを用い、転写パターンの忠実度を適切に維持しつつ合計マスク枚数を削減できるためである。たとえば、[Samsung Electronics](#)は、5nm工程で金属配線層にEUVリソグラフィを利用している。複数の課題を抱えるものの、こうした利点から、多くのメーカーがEUVリソグラフィの導入を急いでいる。

また、高NA EUVリソグラフィ（高NA（開口数）により高解像度が実現）という先端技術への注目も高まっている。[Intel](#)は2024年に、[ASML](#)（NLD）製の世界初の商用高NA EUVリソグラフィ装置の組み立てを完了した。

同装置は、従来のEUV装置と比べて解像度を最大1.7倍向上させ、より微細な回路パターンのプリントを実現するという。また、[ASML](#)のEUV-NXEシステムと比べて画像コントラストが約40%高いとされる。同社は今後2027年までに、先進ノードの「Intel 14A」プロセスの生産開始を計画している。

リソグラフィ工程



出所：Uzabase作成

販売量は仕様決定のタイミングに左右される、価格は歩留まり向上と激しい競争から下落傾向

フォトマスクの需要は、販売量よりもマイクロエレクトロニクス業界の設計活動に左右される。このため、ICやFPDの販売量増加に、フォトマスクの販売量も連動するとは限らない。フォトマスクの販売量に影響する要因は、設計の複雑さ、半導体・FPDの製造技術の変更や新設計の導入などである。フォトマスクの製造は短納期が要求され、顧客から設計データを受領後1日以内に納品という場合もある。業界各社は最小限の受注残で事業運営しており、受注残はIC用では1~2週間分、FPD用では2~3週間分程度に過ぎない。

フォトマスク需要が発生する最初のタイミングは、新しい技術ノー

固定費の高さが収益性・歩留まりに影響

フォトマスク製造は資本集約的なビジネスであり、旧式設備の交換に費用がかかるだけでなく、先端ノードや新たなリソグラフィ技術（EUVリソグラフィなど）によるフォトマスクの開発には継続的な研究開発投資・設備投資が必要となる。したがって、本業界企業の固定費は高い。

固定費の割合が大きいコスト構造と、それに伴う高い営業レバレッジにより、収益性は以下の要因に左右される：

1) 生産能力の限界費用（装置、エッチング、現像など）：リソースの利用率に左右される。たとえば、修正能力が向上すると、修正の歩留まりの直接的な向上につながり、その結果マスク全体の歩留まりが

ドに対応するため、チップメーカーが装置や工程の決定に際しフォトマスクをテストする段階である。次の需要発生タイミングは、半導体製造工程の開発途中で、チップメーカーが歩留まり向上のためにフォトマスクが必要となる段階である。この2つの需要は初期マスク製造と呼ばれ、これに関わることで、半導体メーカーが量産を開始する段階になった際に事業として成立する可能性が高まる。

最後の需要発生は、半導体メーカーが新しい技術ノードで量産する準備が整った段階である。フォトマスクの価格は、各技術ノードの導入時には高値で始まるが、時間の経過とともに、歩留まりの向上、利用性の改善、競合他社との競争などにより下落する傾向にある。

向上してサイクルタイムが短縮される

2) 材料費：マスクブランクスの歩留まりに左右される。これはマスクブランクスの欠陥と品質による

3) 平均販売価格：生産コストではなく市場原理に左右される

4) 販売量：仕様決定タイミングにより決定される

市場環境

フォトマスク市場は今後も成長する見通し

世界のフォトマスク業界の販売サイクルは、半導体・FPDメーカーによる新設計の製品の開発・リリース時期と密接に関係している。

Deloitteによると、半導体業界売上高は2023年に一時的に減少したものの、2020-24年にかけては概ね増加傾向を示し、フォトマスク市場にプラス影響をもたらしている。半導体市場が成長基調を示している主因として、コロナ禍で在宅勤務が浸透し電子機器需要が拡大したこと、ならびに生成AI向けチップの需要高まっていることが挙げられる。なお、2023年に半導体需要が落ち込んだのは、主要各社が過剰在庫に対応するためファブの稼働率を調整したためと考えられる。

IMARCによると、世界のフォトマスク市場は今後2025-33年にかけて約50億ドルから約70億ドル規模へ年平均成長率（CAGR）4%弱で成長する見通しである。

近年フォトマスク需要が堅調に伸びている要因として、1) 半導体業界における高技術ノードへの急速な移行に伴うハイエンド・フォトマスクの需要拡大、2) 家電製品や自動車での利用拡大に伴う既存サイズの需要拡大、3) 中国市場の成長などが挙げられる。

マイクロエレクトロニクス業界の先端技術ノードへの移行が加速、ハイエンド・フォトマスクへの需要が高まる

半導体業界では、大画面の電子機器の需要増や、高性能を実現する高密度チップへのニーズの高まりにより、急速に高技術ノードへの移行が進んでいる。これに伴いハイエンド・フォトマスクへの需要が高まっている。

内製マスクショップは、技術ロードマップ上の特定の分野において専業メーカーよりも積極的に投資を行っている。この傾向は、特にロジックとメモリスパースの分野において顕著である。たとえば、TSMCは2011年に28nmを導入して以来、2022年には3nmプロセスへと

米国の大手フォトマスクメーカー **Photronics** (USA) によると、同社のハイエンドIC用フォトマスクは、2011年以降45nm以下であったものが2018年には28nm以下へ、さらに2025年第1四半期時点では22nmまで微細化が進んでいる（ただしアジアにおいて）。また、ハイエンドFPD用フォトマスクでは、2011年以降は第8世代であったものが2020年以降は第10.5世代以上へと進化している。これらの先端技術ノードでは、複雑さが増し、マスクセットあたりのフォトマスクの枚数が増加するため、フォトマスクの平均販売価格も上昇している。

家電製品の需要増に伴い、既存サイズのフォトマスク需要が好調

ハイエンド・フォトマスクと同様、既存サイズのフォトマスク市場も堅調に推移している（ハイエンド・フォトマスクとは高性能コンピューターの生産に用いられる最先端ノード向けの製品、既存サイズのフォトマスクとは家電製品や自動車の生産に用いられる製品を示す）。既存サイズのフォトマスク市場では、自動車業界やセンサ業界での利用拡大に下支えされ専門メーカーが優位を占める。

なお、先端チップ製造用の300mmファブは、2025年2月現在、ファブ生産能力でリードしているが、資本集約的な性質があるため、150mmや200mmファブに比べてその数は依然として少ない。SEMIによると、300mmのファブ生産能力は2022-26年にかけてCAGR約12%で拡大する見通しである。AIやクラウドコンピューティング分野の急成長に伴い、高性能チップやプロセッサに対する需要が高まり、半導体需要が伸びていることがこの成長を下支えする見込みである。200mmのファブ生産能力もまた、2023-26年にかけてCAGR約14%で成長する見通しである。この成長は、家電製品、センサ、通信用ICの生産に用いられる旧式マスクセットの需要回復に下支えされる見込みである。

急速に進化させ、モバイルや高性能コンピューティング向けのアプリケーションに応用している。

今後も半導体業界では、ハイエンド・高性能デバイスへの需要の高まりと共に、次世代技術ノードへの移行が続くとみられる。なお、**TSMC**は2nm技術の開発を進めており、2025年に量産を開始する計画である。ハイエンド・フォトマスクでは現在、内製メーカーが競争力を誇る。専門メーカーの成功は、こうした動向への迅速な対応にかかっているといえる。

最大のフォトマスク市場は依然としてアジア太平洋、中国は大きな成長可能性を示す

IMARCによると、アジア太平洋は2024年時点で世界のフォトマスク市場の約37%を占め、世界トップの座を維持した。電子機器業界が好調に推移しているのに加え、多くの国が製造設備向け投資を継続的に実施していることが大きい。

国別のICウエハ生産能力構成比をみると、2023年時点では韓国が全体の約22.2%を占め首位につき、これに台湾（22.0%）、中国（19.1%）、日本（13.4%）が続いた（Knometa Research調べ）。上位の中でも中国は、政策による後押しと低コスト生産を背景に国内の半導体産業が大きく拡大した。中国が世界のウエハ生産能力に占める割合は2023-26年にかけて3.2ポイント拡大した。中国は2026年も世界のウエハ市場で引き続き上位を維持すると考えられる。

競争環境

競争激化と資本集約度の上昇を背景に専門メーカー間での統合が進む

専門メーカーは、マイクロエレクトロニクス業界向けに多様なフォトマスクを提供する。本業界では、少数の専門／総合プレイヤーが激しい競争を繰り広げている。また、[Intel](#)（USA）、[Micron Technology](#)（USA）、[Samsung Electronics](#)、[TSMC](#)などの内製メーカーとの競争も激化している。この結果、価格低下の圧力が高まり、多額の資本投資が求められるようになったため、専門メーカー数が減少し市場統合が進んでいる。業界各社は、市場での存在感を高めるため有機的戦略（ハイエンド製品の提供）や無機的戦略（M&A、合併会社の設立）を実施している。

HOYA：マスクブランクスの世界的大手

[HOYA](#)は、情報・通信部門において、1）半導体用マスクブランク、2）FPD用フォトマスク、3）ハードディスクドライブ（HDD）用のガラス基板、4）映像関連製品の研究開発・製造・販売を行う。なお、情報・通信部門は、2023年度（3月期）時点で連結売上高の約30%を占めた。このうちの大半（連結売上高の約25%）をマスクブランク、フォトマスク、HDD用ガラスディスクなどの電子関連製品が占め、残りは映像関連製品となった。

世界フォトマスク市場の主な専門メーカー

企業名	専門／総合	売上高（百万ドル）
凸版印刷	総合	1,846*（2023年度）
大日本印刷	総合	1,630*（2023年度）
HOYA	総合	1,586*（2023年度）
LG Innotek （KOR）	総合	1,071*（2024年）
Photronics	専門	867（2023年度）
Taiwan Mask （台湾光罩、TWN）	専門	231（2023年）
エスケーエレクトロニクス	専門	171（2023年度）
Compugraphics International （GBR）	専門	入手不可

出所：各社公表資料を基にUzabase作成
注1：*HOYAは情報・通信部門、大日本印刷および凸版印刷はエレクトロニクス部門、LG Innotekは基板材料部門の売上高
注2：HOYA、大日本印刷、凸版印刷は3月期、エスケーエレクトロニクスは9月期、Photronicsは10月期

同社は標準的な製品をはじめとして、EUVリソグラフィ技術に対応した製品など、多様な種類のマスクブランク製品を提供していることから、マスクブランク分野で優位を占める。FPD用フォトマスク市場において、中型サイズ（第6世代～第8.6世代）製品部門の成長や中国のパネルメーカーからの需要拡大が見込まれるなか、同社はこれらの急成長市場に対応するため、2021年に中国の大手パネルメーカー[BOE Technology Group](#)（京东方科技集団、CHN）と合併した。これに続き、2022年に[BOE Technology Group](#)との合併会社Chongqing MasTek Electronicsを設立した。同合併会社を通じて、2024年12月にFPDフォトマスクの新工場の操業を開始する計画である。

Photronics：フォトマスク市場の主要専門企業

Photronicsは、既存サイズおよびリーディングエッジノード向けIC・FPD用フォトマスクの主要メーカーである。2023年度時点（10月期）の総売上高に占める割合をみると、IC用フォトマスクは約74%であった。同社は2023年度時点で、世界に11か所の製造拠点を有しており、その内訳は台湾3、米国3、欧州2、中国2、韓国1となっている。顧客数は約675社（2023年度時点）で、そのうち上位2社が2023年度の売上高に占めるシェアはそれぞれ、United Microelectronics（聯華電子、TWN）が約15%、Samsung Electronicsが同12%であった。

2018年度からは、中国の高い成長性を見込み、ICとFPDフォトマスクの生産を国内2拠点で開始した。これにより、IC・FPD用フォトマスクの双方の製造において、中国での先行者利益を得た。2023年度、中国からの売上高は全体の約27%を占め、2018年度の3%から9倍近く増加した。

主要企業の売上高はEUVとエンドユーザーからの需要減を背景に減少している

HOYAの情報技術部門の売上高は、2016-21年度にかけてCAGR約8%で増加した。これは、第6世代・第10.5世代パネル向けのFPDフォトマスク市場が堅調に推移したことに加え、EUVリソグラフィ用のマスクブランクスのなどの高付加価値製品からの売上高が増加したことによる。続く2021-23年度にかけては、EUVとHDD用ガラス基板の需要減を背景にCAGR約-15%で減少した。

エスケーエレクトロニクス の売上高は2019-22年度にかけて、景気回復に伴う有機LEDパネルの需要増加によりCAGR約5%で増加した。続く2023年度は、テレビ販売台数の減少が需給力学に影響を及ぼし、パネル価格に下方の圧力がかかったことから前年度比約16%減となった。

Photronicsの売上高は、2016-22年度にかけてCAGR12%で増加した。この背景には、主力製品の需要が堅調に推移しIC部門の売上高が伸びたこと、ならびにハイエンド製品の需要増によりFPD部門の売上高が伸びたことが挙げられる。続く2023年度は、主力製品の需要が縮

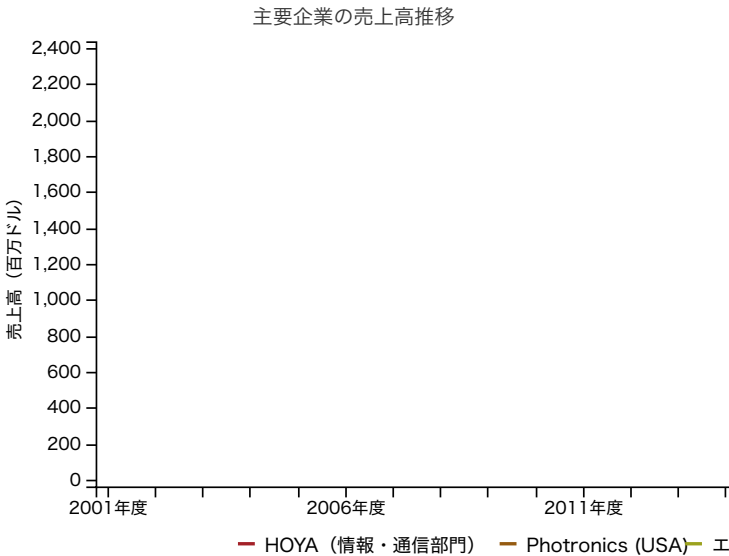
エスケーエレクトロニクス：FPD用フォトマスクの大手メーカー

エスケーエレクトロニクス は、FPD用フォトマスクの製造・販売を行っている。主な顧客は、Tianma Microelectronics（天马微电子、CHN）、サムスン電子ジャパン、Innolux（群創光電、TWN）、BOE Technology Groupなどであり、合わせて2023年度（9月期）売上高の約68%を占めた。製造拠点は、国内に2か所（京都、滋賀）、台湾に1か所の計3か所となっている。日本、台湾、韓国、中国にある支店や子会社を通じて製品販売を行っている。

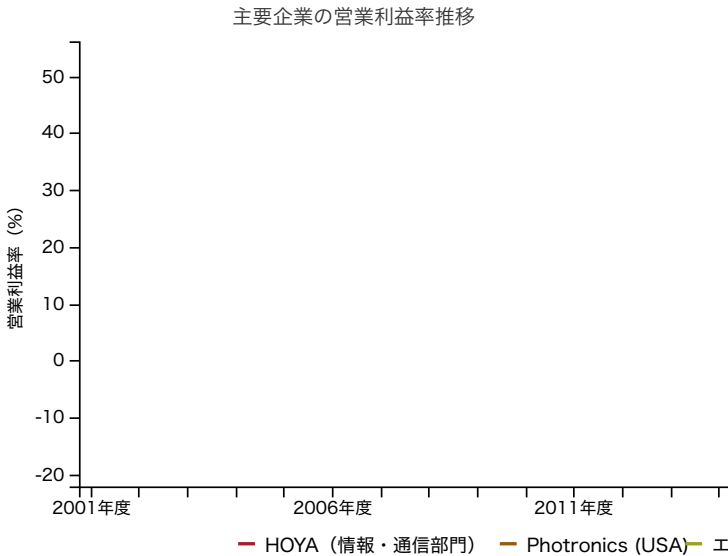
HOYAの情報技術部門の営業利益率は、2020-23年度にかけて47~49%と比較的高い水準で推移した。この主因として、EUV用のマスクブランクスの最先端製品の売上高成長と、製品価格が高い水準で推移したことが挙げられる。

エスケーエレクトロニクス の営業利益率は、2019-22年度にかけて上昇基調を示したのち、2023年度には前年度比約5ポイント低下した。Photronicsの営業利益率は、積極的な価格設定とコスト管理の強化により2021年度に前年度比約12ポイント上昇したのち、2021-23年度にかけて26~28%の幅で概ね横ばいに推移した。

小したため前年度比3%減となった。



出所：各社公表資料
注1：HOYAは3月期、エスケーエレクトロニクスは9月期、Photronicsは10月期
注2：HOYA (情報・通信部門) の2010年度以前のデータは入手不可



出所：各社公表資料
注1：HOYAは3月期、エスケーエレクトロニクスは9月期、Photronicsは10月期
注2：HOYA (情報・通信部門) の2012年度以前のデータは入手不可

業界プレイヤー

[全競合企業を見る](#)

対象企業 <input type="text" value="アナリストによる業界選定のみを表示"/>									
(単位：百万円)	決算期	売上高 合計	親会社株 主に帰属す る当期純利	親会社株 主に帰属す る当期純利	売上高増 加率	期末従業 員数	時価総額	PER	企業価 値/

			益	益率					EBITDA
 TOPPANホールディングス	2025/03	1,717,960	89,348	5.2 %	2.4 %	N/A	1,056,227	10.6 倍	4.6 倍
 大日本印刷	2025/03	1,457,609	110,682	7.6 %	2.3 %	N/A	1,115,833	8.7 倍	6.4 倍
 HOYA	2025/03	866,032	202,101	23.3 %	13.6 %	N/A	5,716,423	28.0 倍	17.2 倍
 Photonics Inc	2024/10	130,517	19,675	15.1 %	-2.8 %	1,878 人	176,143	8.8 倍	2.9 倍
 IMS Nanofabrication (非上場)	2023/12	103,675	9,144	8.8 %	24.9 %	N/A	N/A	N/A	N/A
 HOYA ELECTRONICS SINGAPORE PTE. LTD. (非上場)	2023/03	92,273	22,819	24.7 %	70.5 %	N/A	N/A	N/A	N/A
 Taiwan Mask Corp.	2024/12	35,713	-2,232	-6.2 %	5.0 %	N/A	31,141	N/A	15.5 倍
 日本フィルコン	2024/11	28,639	623	2.2 %	2.3 %	1,312 人	10,906	15.1 倍	6.1 倍
 エスケーエレクトロニクス	2024/09	25,727	2,291	8.9 %	-8.5 %	387 人	28,091	11.2 倍	2.4 倍
 S&S Tech Corp	2024/12	19,593	3,393	17.3 %	17.1 %	299 人	88,754	27.1 倍	16.7 倍
 HOYA ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD. (非上場)	2024/03	18,417	3,694	20.1 %	9.4 %	N/A	N/A	N/A	N/A
 Shenzhen Qingyi Photomask Ltd	2023/12	18,352	2,658	14.5 %	21.3 %	577 人	158,897	59.5 倍	29.3 倍
 ソノコム	2025/03	2,423	211	8.7 %	13.5 %	N/A	4,160	14.2 倍	N/A
 ディー・ティー・ファインエレクトロニクス (非上場)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
 Photonics Semiconductor Mask Corp (非上場)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
業界平均	N/A	347,456	35,724	11.2 %	14.7 %	792 人	838,658	20.4 倍	11.2 倍

- ・ 上記数値は直近株価（直近営業日終値）及び実績値は直近本決算数値を、予想値は会社発表の当期予想を基に計算しております。
- ・ 競合企業は売上高合計順に最大15社まで表示しております。
- ・ デフォルト表示する比較企業の地域（日本企業のみ表示等）は [こちら](#) から変更できます。

・ 業界平均の計算はアナリストにより業界選定された企業のみにより計算されております。